

2022年12月05日 電子デバイス研修講座(専門講座)：WEB配信併用

電子デバイス研修講座(専門講座)：WEB併用	
キャッチフレーズ	<p>実装技術の進化 第三回 ～ 先端実装技術と半導体産業構造の変化を考える ～</p> <p>3Dパッケージング技術と実装技術が今後の半導体産業の発展に重要な役割を果たすようになってきました。証券会社のアナリストの見方、ハイエンドパッケージ用リジッド基板の技術課題、欧米の技術開発状況を確認しながら今後の産業構造と技術動向を議論したいと考えています。 また 専門講座第二回と同様、実装技術の永遠の課題の一つ"放熱技術"についてもわかりやすく解説していただきます。</p>
対象者	半導体パッケージングと実装技術の、材料、装置、プロセスに関するの中堅・経験のあるエンジニアと事業企画ご担当 同時に半導体のユーザーや電子機器のセットメーカーの方にとってもお役に立つと考えています。
会場	日本教育会館喜山倶楽部 光琳の間
WEB参加の場合	Teamsを使用しURLを送付し、接続していただきます。
12月05日 (月)	<p>10:10-11:00</p> <p>半導体実装技術の推移と技術課題</p> <p>加藤凡典 有限会社 エー・アイ・ティ</p> <p>1960年代に日本でも製造が始まった半導体のパッケージング及び実装技術の推移と現在抱えている技術課題について整理します。</p>
	<p>11:10-12:10</p> <p>証券市場から見る半導体産業構造の変化</p> <p>山本義継 みずほ証券</p> <p>半導体パッケージングにかかわる装置・材料メーカーの今後と産業構造の変化について証券アナリストとしてコメントしていただきます。</p>
	<p>12:10-13:10</p> <p>昼食・昼休み</p>
	<p>13:10-14:10</p> <p>パッケージサブストレート用リジッド基板の技術課題</p> <p>小山昌一 サークル エス R&C</p> <p>半導体パッケージサブストレート用リジッド基板の製造技術とその技術課題について解説して頂きます。</p>
	<p>14:20-15:50</p> <p>ヘテロジニアス・インテグレーション</p> <p>宇都宮久修 インターコネクションテクノロジー</p> <p>アメリカおよびヨーロッパにおけるIntel, AMD, IZM, などの chipletの現状などヘテロジニアスインテグレーションの現状を解説して頂きます。</p>
	<p>16:00-16:50</p> <p>電子機器における熱放散技術</p> <p>横内貴志男 関東学院大学 IEEE</p> <p>実装技術の中で常に抱えているテーマが放熱技術です。 スパコンの放熱技術に直接関わった横内氏に熱放散技術について解説していただきます。</p>